경제혁신 희망의 새시대
산업통상자원부 보 도 자 료
http://www.motie.go.kr

2016년 4월 27일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 26일(화) 오전 11시 이후 보도 가능)

배포일시	2016. 4. 26. (화)	담당부서	전자부품과
담당과장	김정화 과장 (044-203-4270)	담 당 자	한비룡 주무관(044-203-4277)

국제전자회로산업전 (KPCA Show 2016) 개최

- 전자제품의 신경회로, 「전자회로기판」 미래기술 전시 -

- 15개국 239개사 720부스 출전, 전자회로 업계 유공자 포상 진행 -

□ 산업통상자원부(장관: 주형환)가 주최하고 한국전자회로산업협회가 주관하는 "**제13회 국제전자회로산업전**(KPCA SHOW 2016; International Electronic Circuits Show)"이 일산 킨텍스에서 4.26일부터 28일까지 3일간 열린다.

< 제13회 국제전자회로산업전 개요 >

- 일시/장소 : `16.4.26(화) ~ 4.28(목), 일산 킨텍스 제2전시장 7홀
- 참석규모 : 15개국 239개 참가업체(720부스), 해외바이어 및 관람객 약 15,000명(추정)
- 주요일정 : 전자회로기판(PCB) 신제품 전시(4.26~28), 리셉션(4.26), 국제심포지엄(4.26~28), 신제품·신기술 발표회(4.27), 세계전자회로기판협회(WECC)회의(4.26) 등

□ 이번 행사에는 기판 제조업체 및 후방산업인 원자재, 설비, 약품업체 등 15개국 239개사에서 720부스 규모로 국내 최대의 전자회로기판 전시회가 마련되고, **심포지움, 신제품·신기술 세미나, 세계전자회로협회**(WECC*) **회의** 등 다양한 행사가 연계되어 열린다.

* WECC : World Electronic Circuits Council

○ 이번 전시회는 각 국의 전자회로기판(PCB) 산업에 대한 활발한 **기술교류 및 정보공유의 장을 제공**하여 **국내 전자회로기판 산업 경쟁력 강화**에 크게 기여할 것으로 기대된다.

○ 더불어 해외수출 지원을 위해 다양한 전자 산업군의 **해외 구매자(바이어)를 초청**하여 **제품 구매상담 등 다양한 사업기회도 제공**한다.

* 15년 실적 : (상담) 521.5백만불, (계약) 134.3백만불, <출처: 한국전시산업진흥회>

□ 전자회로기판(PCB)*은 TV, 냉장고, 세탁기 등 일반 가전제품 뿐만 아니라 스마트폰, 웨어러블 기기, 스마트카 등 첨단제품의 신경회로에 해당하는 주요부품으로 2015년 국내 전자회로기판(PCB)산업은 **생산액 기준 9.1조 원, 세계 3위****의 시장규모로 성장했다.

* PCB(Printed Circuit Board) : 페놀이나 에폭시 등의 절연판에 구리 등 도체를 입혀 전기회로를 형성한 기판

** '15년 전세계 생산액: 581억 달러, 국가별(억 달러): 대만(192)→일본(140)→한국(82)→중국(60)

○ 올해는 모바일 및 네트워크용 기판 및 전장용 기판의 소폭 생산 증가로 1.1% 성장한 9.2조원을 기록할 것으로 보인다.

□ 전시회 첫날 리셉션에서는 **국내 전자회로 산업발전에 기여한 업계 유공자**에게 **산업통상자원부 장관표창 3점이** 수여됨

* 산업통상자원부 장관표창 (3점) : 엘지(LG)이노텍 황정호 연구위원, 필옵틱스 이상환 전무, 제4기한국 박윤철 부장

< 리셉션 개요 >

- 일시·장소 : 4.26(화) 17:30~20:30/킨텍스 제2전시장 303~304호
- 참 석 자 : 산업부 전자부품과장, 한국전자회로산업협회 회장, 주요 PCB 협회 회장, 해외바이어, 참가업체 등 300여명

□ 산업통상자원부는 축사에서 세계적인 경기침체, 전자회로기판(PCB) 전방산업 성장률 감소 등 국내 전자회로 산업이 당면한 도전을 극복하고 산업 경쟁력을 높이기 위해,

○ 미래 융·복합 추세에 맞춰 **고부가가치 제품 생산 확대를 위한 원천기술 개발 및 연구개발 생태계 조성 지원**을 추진하기로 했다.

※ 붙임: 전시회 및 세미나 개요 각 1부, 주요참석자 명단 1부. 끝.

이 보도자료에 대하여 자세한 내용을 원하시면 산업통상자원부 전자부품과 한비룡 주무관(044-203-4277)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1 국제전자회로산업전(KPCAshow2016) 행사 개요

□ 전체 행사개요

구분	날짜	행사내용		
개막식	4.26(화)	○ (일시·장소) 10:00~11:00, 킨텍스 제2전시장 7홀 입구 ○ (참가자) 해외협회(7개국) 및 참가 업체 대표 등 총 12여명 ○ (행사내용) 테이프 컷팅		
리셉션		○ (일시·장소) 17:30~20:30, 킨텍스 제2전시장 303~304호 ○ (참가자) 정부인사, 참가업체 대표, 해외협회장, 바이어 등 총 300명 ○ (행사내용) 유공자 정부 시상 및 만찬		
주요행사	4.26(화) ~ 4.28(목)	**심포지엄** (15개 주제발표)	**신제품·기술 세미나** (4.27, 3개 주제)	**전문가 회의** (WECC 회의, IEC TC 전문가 회의)

□ 리셉션 행사개요

○ 주요내용 : PCB 유공자 정부 시상 및 관련업계 격려(산업부 장관표창 3점)

○ 일시·장소 : '16.4.26(화) 17:30~20:30, 킨텍스 제2전시장 303~304호

○ 참 석 자 : 산업통상자원부 전자부품과장, 한국전자회로산업협회 회장, 주요 PCB협회 회장, 해외바이어, 참가업체 등 300여명

진행 시간	세부 내용	비 고
17:30~17:35	환영사	KPCA 회장
17:35~17:45	축 사	산업부 전자부품과장
17:45~18:00	정부 시상 및 기념 촬영	산업부 전자부품과장
18:00~18:05	각국 협회장 소개	사회자
18:05~18:10	귀빈 기념 촬영	참석자
18:10~18:12	건배 제의	참가社 대표
18:12~20:30	만 찬	참석자

붙임 2 국제 심포지엄 및 신제품·기술 세미나 개요

□ 국제 심포지엄

○ 일시 및 장소 : '16.4.26~28일, 킨텍스 제2전시장 세미나룸 301-302호

시간	4월 26일 (화)	시간	4월 27일 (수)	시간	4월 28일 (목)
13:00 ~ 13:40	**세계 전자회로기판 시장 동향** Prismark Partners LLC/ Mr. J.Philip Plonski	13:00 ~ 13:40	**Iot, Wearable 시장 동향** 대신증권 / 박강호 팀장	13:00 ~ 13:40	**IC Packaging 기술 동향 및 로드맵** 앰코테크놀로지코리아(주)/ 성경술 차장
13:50 ~ 14:30	**WLP(Wafer Level Package) 기술 동향** ASE group / Dr. Walter Jau	13:50 ~ 14:30	**중화권 PCB 시장 동향 및 전망** CPCA / Mr. Kevin Yan	13:50 ~ 14:30	**PI 필름 기술 개발 동향** SKC코오롱PI / 백승열 대리
14:40 ~ 15:20	**PCB 및 소재 UL 인증 동향** UL / Ms Crystal Vanderpan	14:40 ~ 15:20	**IoT, Packaging 기술 및 시장동향** Interconnection Technologies, Inc. / Henry H. Utsunomiya, President	14:40 ~ 15:20	**기판 소재 기술 동향** (주)두산전자BG / 고창훈 수석
15:30 ~ 16:10	**FPCB 기술 동향** (주)비에이치 / 성민우 차장	15:30 ~ 16:10	**Wearable FPC 시장 및 기술 동향** NIPPON MEKTRON / Hirofumi MATSUMOTO, Ph.D.	15:30 ~ 16:10	**고다층 기술 동향** (주)이수페타시스 / 이영호 과장
16:20 ~ 17:00	**자동차용 전장품(PCB) 신뢰성 동향** 자동차부품연구원 / 위신환 센터장	16:20 ~ 17:00	**반도체 기판 기술 동향** 퀄컴 코리아 / 강귀원 차장	16:20 ~ 17:00	**디바이스별 반도체 기판 적용사례** LG이노텍(주) / 황정호 연구위원

□ 신제품·기술 세미나

○ 일시/장소 : '16.4.27(수) / 킨텍스 제2전시장 회의실 307호

시 간	주 제	발 표 사
10:30-11:30	* 수평도금장비 - IC Carrier Package * Horizontal equipment technology for metallization of high-end IC Carrier Package	㈜에스이에이 S.E.A.CO., LTD.
13:30-14:30	* UL의 새로운 서비스 * UL's New Services beyond UL Mark	UL
15:00-16:00	* SAP 공법을 적용하는 차세대 IC Sub.를 위한 신규 High Throw 화학동 * High Throw Electroless Copper for Semi-Additive Process Technology	아토텍코리아 Atotech Korea

붙임 3 리셉션 주요 참석자

연번	사진	주요약력
1		**성명/소속** Rex Rozario / WECC (세계PCB협회) **약력** ・WECC (세계PCB협회) 의장 ('15년~'17년) ・EIPC (유럽PCB협회) 회장
2		**성명/소속** 김경희 / KPCA (한국PCB협회) **약력** ・KPCA 회장 ・에피디어 회장 (PCB 제조업체)
3		**성명/소속** 안재화 / KPCA (한국PCB협회) **약력** - KPCA 수석부회장 - 세일전자 대표이사 (PCB 제조업체)
4		**성명/소속** 남원기 / KPCA (한국PCB협회) **약력** - KPCA 국제위원장 - 선진하이엠 대표이사 (PCB 제조업체)
5		**성명/소속** Morrison LIANG / TPCA (대만PCB협회) **약력** - TPCA Vice Chairman - C SUN MFG LTD Chairman (대만 FPC 제조업체)
6		**성명/소속** You LEI / CPCA (중국PCB협회) **약력** - CPCA Chairman - CCTC 대표이사 (중국 PCB 제조업체)
7		**성명/소속** Keitaro IWAKI / JPCA (일본PCB협회) **약력** - JPCA 부회장 - President & CEO, Meltex Inc. (일본PCB약품·설비업체)
8		**성명/소속** Marc CARTER / IPC(미국PCB협회) **약력** - IPC Director
9		**성명/소속** Viral BHULANI / IPCA (인도PCB협회) **약력** ・IPCA 회장